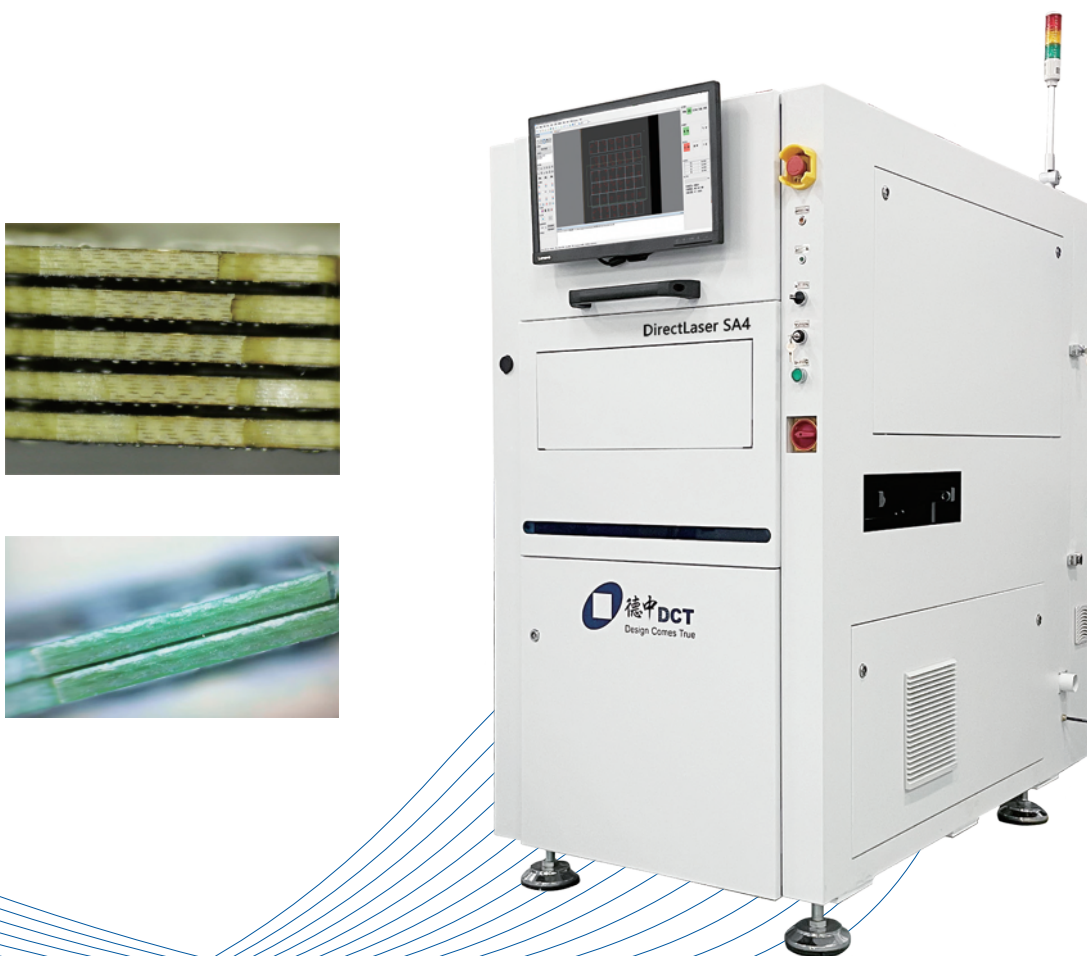


德中DirectLaser SA4

PCBA轨道式激光精密切割分板系统

Online PCBA/FPCBA-Precise laser cutting system

高精度，高品质，电路板精密分板之选
智能化，模块化，自动生产线搭建方案



- 直接数据驱动，快速导入，产品切换迅速
- 超快洁净切割，无后处理，提升分板品质
- 精确激光控制，工艺融合，精度效率并重
- 模块设计组装，结构紧凑，拓展维护便捷
- 操作简单快捷，引导操作，快速产品切换
- 标配轨道在线，快速接入，智能产线优选

激光切割分板设备相比机械分板设备，具有无接触、无应力、低粉尘、快速灵活、高能效比等突出优势。激光精密切割分板精度高，可满足全切、断点切割、邮票孔切割、V-CUT切割等各种分板需求，产品不受图形限制，不会产生变形，适用于高端精密产品的应用，加工后产品无毛刺，光滑整齐。

SMT智能生产线专业之选

设备采用轨道式在线加工方案，最大加工尺寸可达350x350mm幅面，结构紧凑，可快速并入SMT生产线，适用于各类PCBA外形分板需求，通过装载不同产品治具，标配三段式轨道上下料结构，轻松实现各类产品切换；引导式操作，让员工迅速上手；安全可靠，符合中国、欧盟电气标准设计，加工区域全封闭，保证加工过程的安全防护；可根据生产需求，接入工厂MES系统，实现全流程生产管控。

业内独有数据处理软件 CircuitCAM Laser

30年历史，为直接加工技术的发展奠定了基础，装机量远超万套；Laser版本横空出世：可满足激光精密激光切割、激光钻孔等各类激光加工应用，可自动生成激光加工路径，配备组合加工方案可以根据需求进行激光参数、加工路径优化选择，明显提升加工质量和速度，减少生产流程，降低成本。

模块化设计，一体化组装

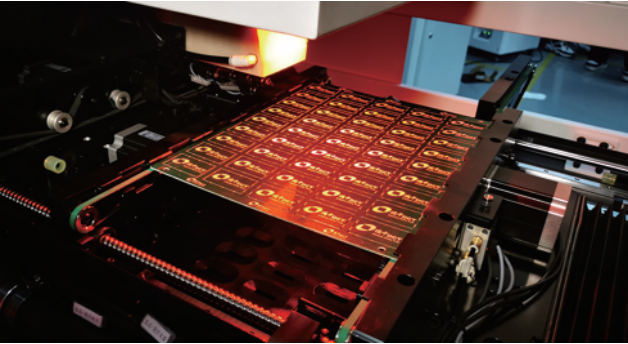
采用模块化设计，根据材料特性和加工质量要求，可配置多种波长（紫外、绿光）及脉宽（纳秒、皮秒）激光器。标准化平台，批量化组装，长期验证，稳定可靠，可选项丰富，可满足客户各类应用需求。

“速度—效率—精度”三者兼顾

高速运动控制系统配合CCD对位系统，保证加工过程高速高精度加工；融合完备精度校准体系，根据机型和配置不同，辅以涨缩、高度、功率补偿等，突破极限，又快又准。切割分板精度高，洁净加工无分层，无任何碳化、熔融，为SMT行业切割分板树立了新的标杆。

专有分板清洁加工工艺

独创“激光边缘重塑（LBR）”技术，结合了高精度硬件平台和强大软件辅助制造技术，通过特有加工路径规划和精确参数调控，专用于切割边缘清洁处理。



技术参数	DirectLaser SA4
最大幅面	350mm*350mm
设备平台	大理石平台，直线电机驱动
激光脉宽	纳秒、皮秒可选
激光波长	355nm/532nm
X/Y轴分辨率	0.5μm
重复定位精度	±2μm
数据处理软件	CircuitCAM7 Laser
设备驱动软件	DreamCreaTor3
自动上下料系统	三段式轨道传送
摄像头靶标对位系统	标配
工业吸尘系统	标配
机器尺寸（WxHxD）	940mm x 1,720mm x 1,650mm
电源	3×380V+N+PE, 50Hz, 3.0kW
环境温度	22 C±2 C
设备重量	1,500kg

参数更改，恕不另行通知



德中（天津）技术发展股份有限公司
天津市西青区海泰华科一路11号C座 Tel.: 022 83726901 Fax: 022 83726903
Http://www.dct-china.cn Email:sales@dct-china.cn